

お問合せ先
OBARA GROUP株式会社
〒242-0007 神奈川県大和市中央林間3-2-10
TEL. 046-271-2122

適切に選別された森林からの原料を含むFSC®認証紙と環境に配慮した植物油インキを使用
して造ります。



www.obara-g.com

OBARA-G REPORT

第59期 第2 四半期報告書

2016年10月1日 …… 2017年3月31日

証券コード 6877

株主の皆様へ

株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。OBARA GROUPの2017年第2四半期連結累計期間における事業の概況等をご報告致します。

世界経済は、米国において景気拡大の動きが持続したものの、アジア地域を始めとする新興国や欧州地域の緩やかな景気回復から、全体として低成長で推移しました。

我が国経済につきましては、個人消費の回復に足踏みが見られたものの、設備投資や工業生産が持ち直しの動きを示すなど、緩やかな景気回復が続きました。

そのような外部環境の下、溶接機器関連事業が、円高推移の中で自動車メーカーの堅調な生産活動や設備投資への対応を継続的に展開し、平面研磨装置関連事業が、設備投資の持ち直しが見られ始めたエレクトロニクス関連素材への拡販活動に努めましたが、当社の業績は、前年同期を下回る結果となりました。

なお、当社は株主の皆様に対する利益還元を経営上の重要政策として認識しており、2017年度の第2四半期末配当金につきましては、1株につき30円とし、本年6月12日を支払開始日とさせていただきます。



今後も不透明な経済環境が予想されますが、当社と致しましては、引き続き成長市場への経営資源の投入を積極的に推進し、顧客ニーズを満たす製品及びサービスの提供を行うことにより、業績向上に努めてまいります。

株主の皆様におかれましては、OBARA GROUPへの倍旧のご支援を心よりお願い申し上げます。

2017年6月

取締役社長 小原 康嗣

目次	株主の皆様へ ▶01	セグメント別事業概況 ▶05	主要経営指標の推移 ▶11	会社情報 ▶16	株主メモ ▶18
	営業の概況 ▶03	トピックス ▶09	連結財務データ ▶13	株式情報 ▶17	

営業の概況

連結業績サマリー

(百万円)

	第2四半期累計期間			通期		
	前期	当期	前年同期比	前期	当期(予想)	前期比
売上高	27,720	21,833	△21.2%	50,141	45,500	△9.3%
営業利益	6,073	4,105	△32.4%	9,745	7,200	△26.1%
経常利益	6,067	4,518	△25.5%	9,457	7,450	△21.2%
親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益	3,719	2,867	△22.9%	7,066	5,000	△29.2%
1株当たり配当金	30円	30円	—	90円(年間)	60円(年間)	△30円

(注) 前期の期末配当金(確定)／1株当たり配当金60円
 当期の期末配当金(予想)／1株当たり配当金30円

03

第2四半期連結累計期間の概況について

当社グループと深く関わる自動車業界では、中国を中心としたアジア地域と米州地域などで、新モデル投入などによる設備投資が行われるとともに、生産活動についても堅調な動きが見られました。一方、同じく当社グループと深く関わるエレクトロニクス業界では、不透明な需給見通しなどを受け設備投資への慎重対応を継続する向きが見られました。

当社グループは、このような経営環境において各市場動向に応じた拡販に努め、ローカルニーズに対応した製品投入を進めたものの、第2四半期連結累計期間の業績は、前年同期を下回る結果となりました。

通期の見通しについて

自動車業界では、世界各地域において、堅調な設備投資や生産動向の継続が見込まれております。また、エレクトロニクス業界では、先端デバイスなどの活発化傾向を受け、エレクトロニクス関連素材における設備投資の持ち直しが予想されております。そのような環境下、当社グループの通期業績につきましては、期初計画の水準を予想しておりますが、当社グループとしましては、成長市場での販売促進を鋭意図るとともに、積極的な設備投資と研究開発を行ってまいります。

なお、当連結業績予想は、1米ドル=105円の為替レートを前提としています。

04

セグメント別事業概況

溶接機器
関連事業

事業紹介

溶接機器関連事業とは

自動車業界を主要マーケットとする高効率な抵抗溶接機器を製造・販売しています。

自動車が出来るまで

●溶接機器関連事業と関わる自動車の製造プロセス

車体溶接

塗装

ぎ装

完成

出荷



車体溶接の設備

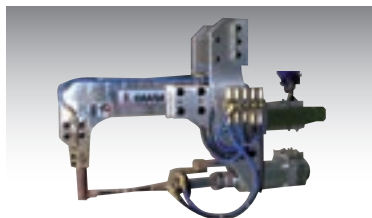
OBARA GROUP が提供する溶接機器

自動車ボディは薄板鋼板で構成されるため、抵抗溶接という接合工法が採用されています。

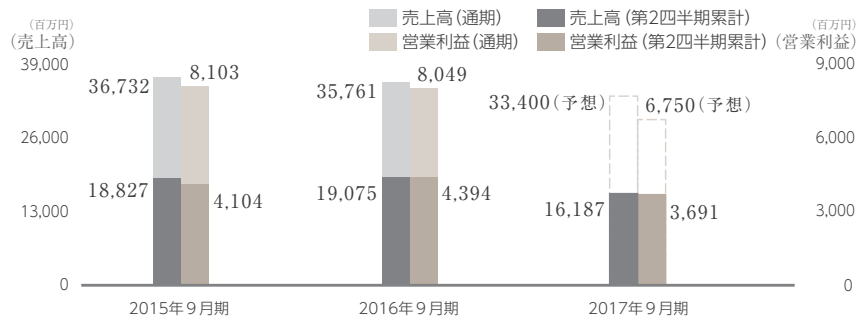
抵抗溶接は、接合ポイントに適切な加圧力と溶接電流を与える必要があります。自動車ボディの組立てには、各自動車モデル固有の立体形状に合わせ、個々の接合ポイントにカスタマイズされた溶接機器が設計・製造されます。

私たちは、国内外の自動車メーカーが行う設備増強やモデルチェンジに伴う設備更新に対し、半世紀に亘って培った経験と最先端の設計・生産技術により、最適な抵抗溶接設備を提案します。日々の生産活動に不可欠な消耗品と合わせ、自動車業界のパフォーマンス要望に応えます。

溶接機器関連事業



溶接ガン



(注) 売上高については、外部顧客に対する売上高を記載しております。

溶接機器関連事業につきましては、取引先である日系・欧米系・アジア系自動車メーカーにおいて、中国を中心としたアジア地域や米州地域などで堅調な設備投資が行われ、世界各地の自動車生産は概ね高水準となりました。このような環境の下、当事業として設備品及び消耗品の拡販を図ったものの、前年同期に比べ円高に推移した影響などを受けて、業績は前年同期を下回りました。

この結果、当事業の売上高は161億87百万円(前年同期比15.1%減)となり、同営業利益は36億91百万円(前年同期比16.0%減)となりました。

売上高構成比



セグメント別事業概況

平面研磨装置
関連事業

事業紹介

平面研磨装置関連事業とは

エレクトロニクス業界を主要マーケットとする精密研磨装置を製造・販売しています。

エレクトロニクス製品が出来るまで

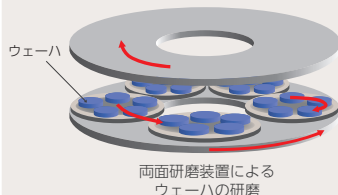
●平面研磨装置関連事業と関わるエレクトロニクス製品の製造プロセス

ウェーハ製造工程
インゴット引き上げ、切断、
ウェーハ研磨

半導体デバイス前工程
成膜、リソグラフィ、
エッチング等

半導体デバイス後工程
ダイシング、ボンディング、
モールドイング等

エレクトロニクス製品組込
完成した半導体デバイス(チップ)の
エレクトロニクス製品への搭載



OBARA GROUP が提供する平面研磨装置

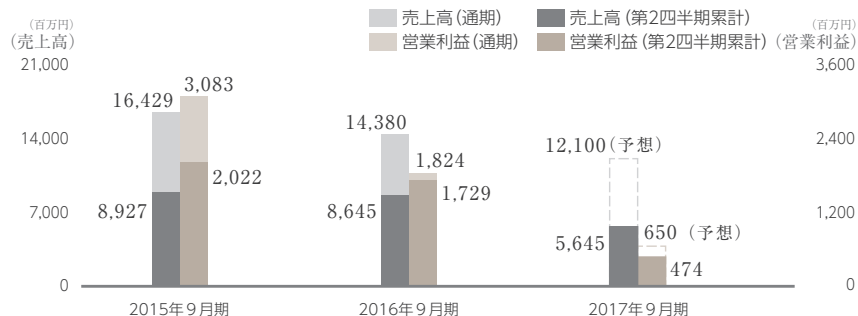
精密加工により製造される先端エレクトロニクス製品は、材料段階で高い面精度を基準平面として要求します。ロジックチップ・メモリーなどの半導体デバイスに用いられるシリコンウェーハ、通信・光デバイス基板、ハードディスク基板など、多様なエレクトロニクス素材の面精度の形成に、ダメージのない微細加工が可能な、遊離砥粒研磨装置が活躍しています。

現代社会を支える各種エレクトロニクス素材の期待水準に、私たちは、ナノオーダー対応の遊離砥粒研磨装置を中心とした精密装置ラインナップで応えます。また、信頼性の高い量産プロセスの確立に必要な、スラリー・研磨パッドなどの消耗副資材も開発・販売しています。

平面研磨装置関連事業



両面研磨装置



(注) 売上高については、外部顧客に対する売上高を記載しております。

売上高構成比



平面研磨装置関連事業につきましては、スマートフォンなど主要エレクトロニクス製品の堅調な販売動向を受け、取引先であるエレクトロニクス関連素材において、生産活動の回復が顕著となりましたが、設備投資については慎重な持ち直しの動きとなりました。このような環境の下、当事業として設備品及び消耗品の拡販を図ったものの、業績は前年同期を下回りました。

この結果、当事業の売上高は56億45百万円(前年同期比34.7%減)、同営業利益は4億74百万円(前年同期比72.6%減)となりました。

トピックス

平面研磨装置関連事業

日本新オフィス兼研究棟竣工

平面研磨装置関連事業の中核を担うオフィス兼研究棟が、2017年2月に神奈川県綾瀬市に完成し、稼働を開始しました。留まることがない顧客ニーズの高度化に、充実した開発環境と創意あふれるエンジニアによって中長期にわたり対応して行くことがその狙いです。当社グループは、現代社会を支えるエレクトロニクス関連素材の要求水準を充足するため、新たな加工プロセスを提案し続け、それらを具現化する高付加価値の装置及び消耗副資材の開発に一層注力してまいります。



新オフィス兼研究棟



片面研磨装置

09

平面研磨装置関連事業

SEMICON Japanに出展

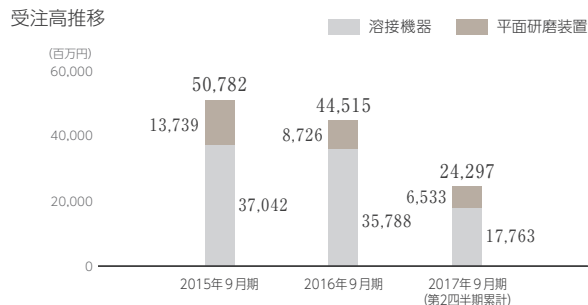
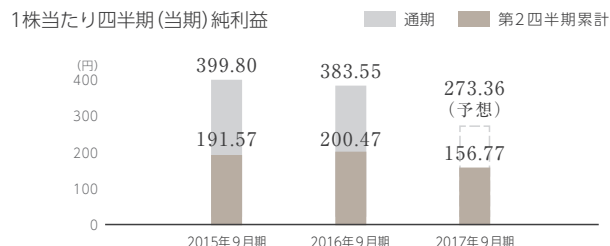
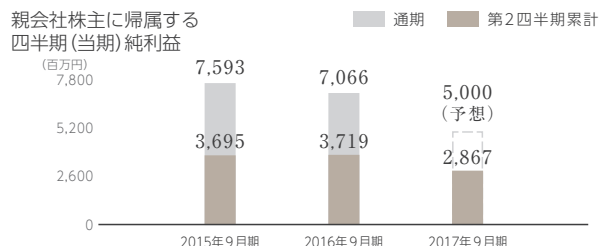
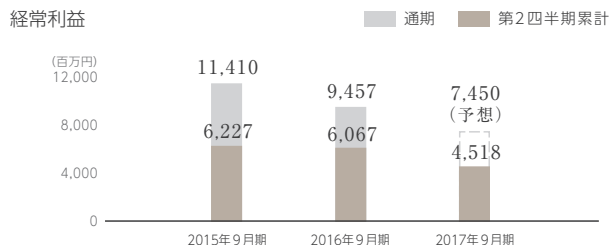
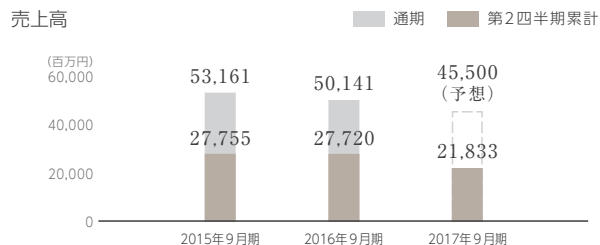
スマートフォンなどのエレクトロニクス製品には、最先端の半導体デバイスが搭載され、そのデバイスが形成されるシリコンウェーハの高精度化が進んでいます。2016年12月、半導体製造技術の展示会「SEMICON Japan」が東京ビッグサイトにおいて開催され、当社グループは、高精度シリコンウェーハの安定量産に最適な装置・消耗副資材の総合ソリューションを提案したほか、SiCやGaNなどの新素材や、次世代の通信関連基板に対応した製品ラインナップについても紹介しました。



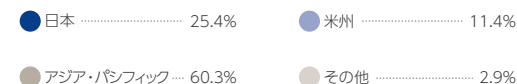
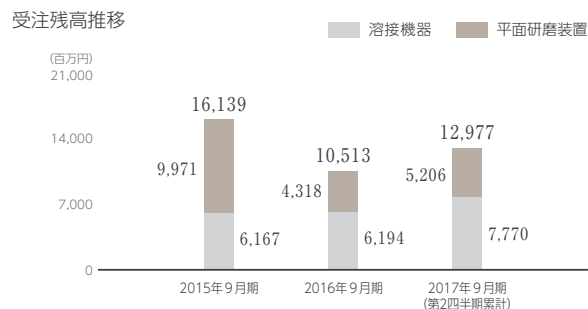
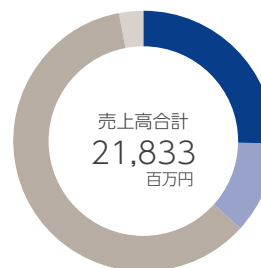
SEMICON Japan 2016

10

主要経営指標の推移



地域別売上高構成比

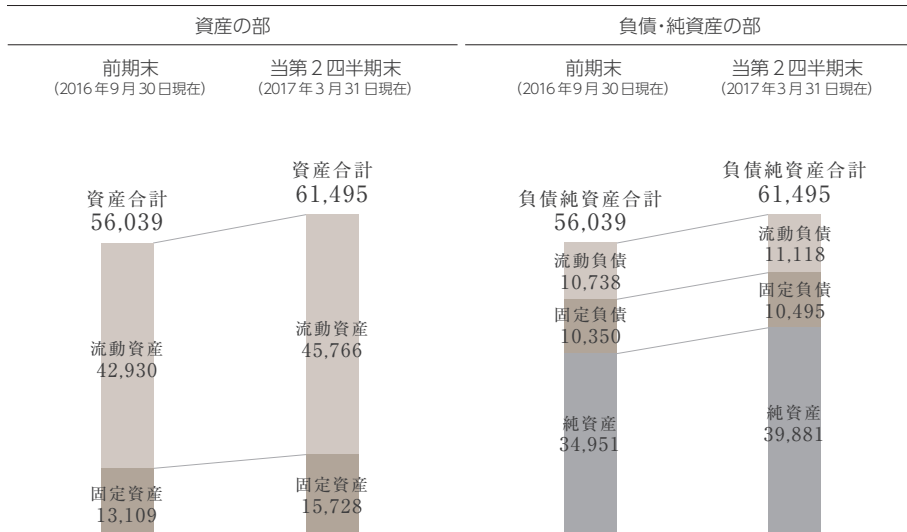


(注) 売上高については、外部顧客に対する売上高を記載しております。

連結財務データ

資産・負債・純資産の状況

(単位：百万円)



資産・負債

point
1

総資産は614億95百万円と、前期末に比べて54億55百万円増加しました。現金及び預金が12億69百万円減少した一方、受取手形及び売掛金が13億60百万円、有価証券が12億75百万円、棚卸資産が13億66百万円、有形固定資産が26億30百万円増加したことなどによります。

負債は216億13百万円と、前期末に比べて5億25百万円増加しました。賞与引当金が4億8百万円、その他流動負債が4億48百万円減少した一方、支払手形及び買掛金が6億13百万円、前受金が3億27百万円増加したことなどによります。

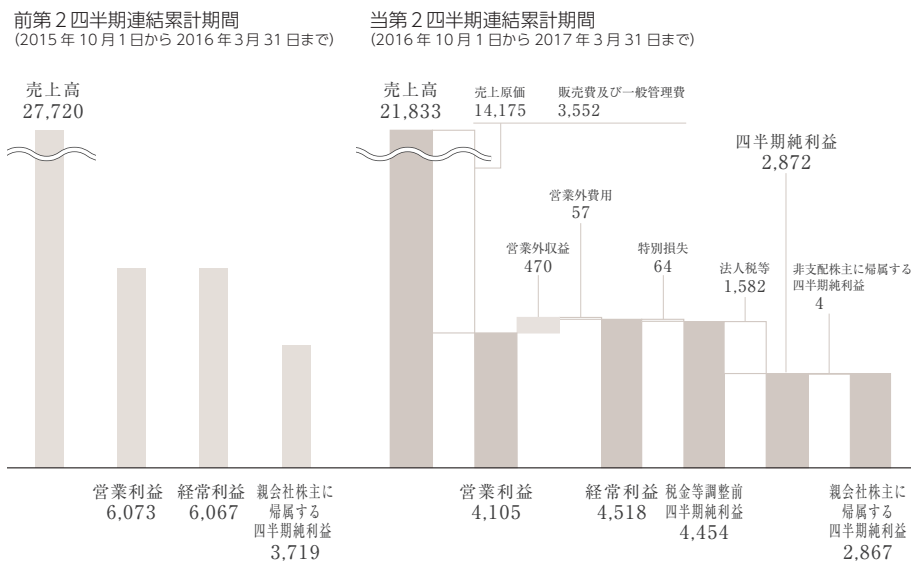
純資産

point
2

純資産は398億81百万円と、前期末に比べて49億30百万円増加しました。利益剰余金が17億64百万円、為替が前期末より円安のため為替換算調整勘定が30億円増加したことなどによります。

損益の状況

(単位：百万円)



売上高・営業利益・ 経常利益・親会社株主に 帰属する四半期純利益

point
3

連結売上高218億33百万円(前年同期比21.2%減)、営業利益41億5百万円(前年同期比32.4%減)、経常利益45億18百万円(前年同期比25.5%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益28億67百万円(前年同期比22.9%減)となりました。

営業外収支

point
4

為替差益2億18百万円など、営業外収益が4億70百万円となった一方、オフィス兼研究棟への移転費用17百万円など、営業外費用が57百万円となりました。

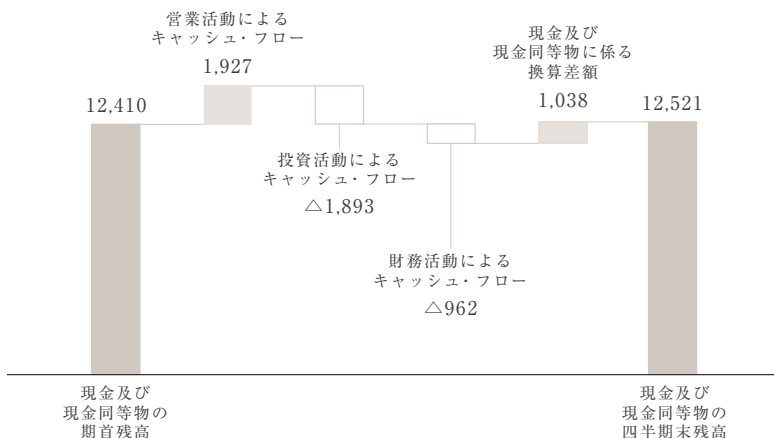
連結財務データ

キャッシュ・フローの状況

当第2四半期連結累計期間

(2016年10月1日から2017年3月31日まで)

(単位：百万円)



point
5

営業活動による キャッシュ・フロー

営業活動により得られた資金は19億27百万円となりました。税金等調整前四半期純利益が44億54百万円、取用補償金の受取額が5億30百万円となった一方、賞与引当金の減少額が4億68百万円、売上債権の増加額が1億64百万円、たな卸資産の増加額が6億69百万円、前受金の減少額が5億29百万円、法人税等の支払額が9億66百万円発生したことなどによります。

point
6

投資活動による キャッシュ・フロー

投資活動により支出した資金は18億93百万円となりました。定期預金の純減少額が6億92百万円、投資有価証券の売却及び償還による収入が3億99百万円となった一方、有形固定資産の取得による支出が28億50百万円発生したことなどによります。

point
7

財務活動による キャッシュ・フロー

財務活動により支出した資金は9億62百万円となりました。短期借入金の純増加額が1億58百万円となった一方、配当金の支払額が10億98百万円発生したことなどによります。

15

会社情報

(2017年3月31日現在)

会社概要

商号	OBARA GROUP 株式会社
設立	1958年12月
資本金	19億25百万円
従業員数	20名(連結 1,623名)
本社所在地	神奈川県大和市中央林間3-2-10 046-271-1111(代表)
主な事業	持株会社として、グループ全体の経営戦略の策定・推進、グループ経営の監査、その他経営管理
ウェブサイト	http://www.obara-g.com/

役員

取締役社長	小原 康 嗣
取締役	小林 憲 史
取締役	周 澤 健
取締役	山下 光 久
社外取締役	大西 倫 雄*
常勤監査役	谷 内 博
社外監査役	須 山 正 志*
社外監査役	牧 野 宏 司*

* 証券取引所が定める独立役員として届出を行っております。

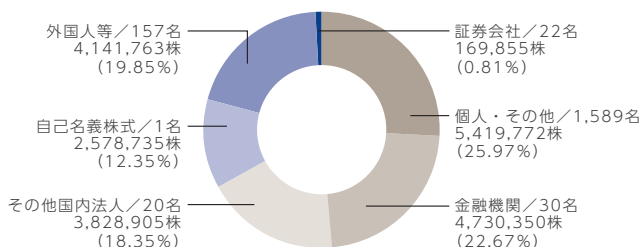
16

株式情報 (2017年3月31日現在)

株式状況

発行可能株式総数	38,000,000株
発行済株式総数	20,869,380株
単元株式数	100株
株主数	1,819名

株主分布状況



大株主

株主名	持株数(千株)	持株比率(%)
有限会社馬込興産	3,703	20.24
小原 康嗣	2,571	14.05
日本トラスティ・サービス 信託銀行株式会社(信託口9)	1,563	8.54
JP MORGAN CHASE BANK 385632	1,078	5.89
日本マスタートラスト 信託銀行株式会社(信託口)	804	4.39
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 380578	512	2.80
株式会社三菱東京UFJ銀行	369	2.02
日本トラスティ・サービス 信託銀行株式会社(信託口)	354	1.93
小原 範子	304	1.66
GOVERNMENT OF NORWAY	269	1.47

- (注) 1. 上記のほか、自己株式2,578千株を保有しております。
 2. 持株比率は、自己株式2,578千株を控除して計算しております。
 3. 小原康嗣の持株数は自身の管理分株数1,084千株を加えて表示しております。

株主メモ

事業年度	毎年10月1日から翌年9月30日まで
定時株主総会	毎年12月
基準日	定時株主総会の議決権 毎年9月30日 期末配当 毎年9月30日 第2四半期末配当 毎年3月31日 その他必要があるときは、あらかじめ公告して定めます。
株主名簿管理人	〒100-8233 東京都千代田区丸の内1-4-1 三井住友信託銀行株式会社
特別口座の 口座管理機関	東京都千代田区丸の内1-4-1 三井住友信託銀行株式会社
同事務取扱所 (郵便物送付先 お問い合わせ先)	〒168-0063 東京都杉並区和泉2-8-4 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 TEL: 0120-782-031(フリーダイヤル)
同取次窓口	三井住友信託銀行株式会社 全国各支店

公告方法 当社公告につきましては、下記ウェブサイトに掲載いたします。
<http://www.obara-g.com/>
 但し、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告を行なうことができない場合は、日本経済新聞に公告を掲載いたします。

年間IRスケジュール

